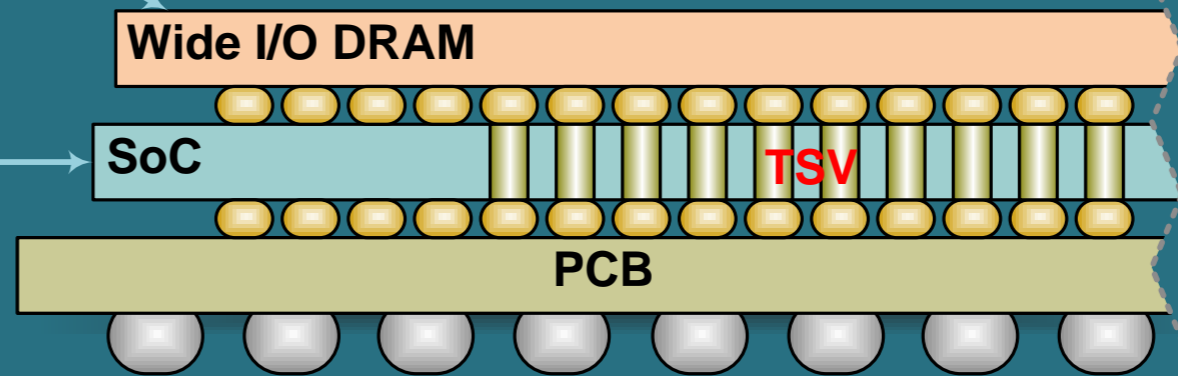


Wide I/O Solutions

mono Wide I/O Solution

Wide I/Oインターフェイスのマイクロバンプを備えているが、TSVを使わないDRAMダイ

SoC側は原則としてTSV技術が必要(裏返してPCBとワイヤボンディングで結ぶ手法などを取ればTSVは不要)



4 stacked Wide I/O Solution

メモリキューブ(Memory Cube)
Wide I/O DRAMをTSV技術で2~4
ダイスタックしたメモリキューブ

